

2025年2月26日 IR Day Q&A

■ 質問一覧

- Q1 中期経営計画の最終年度(FY2027)が迫ってきている。3兆円という売上高の目標に対して、主要製品ごとにどのように増収に貢献していくかイメージを教えてください。また、営業利益率について、FY2025 Q3の実績が30.5%であったが、中期経営計画の目標である35%に向けて、売上高拡大以外の要素でどの程度利益率を向上していけるとみているか、中期経営計画とIR Dayの説明内容を踏まえて説明してほしい。
- Q2 中期経営計画の目標に関連して、FY2027に売上高3兆円、営業利益率35%という中期経営計画の目標を達成できれば、営業利益が1兆円を超える。自己資本が大きくなり、ROE30%という目標に達しなくなると思う。ここ数年、積極的な株主還元をしているが、ROEの達成を念頭におくと、引き続き、自己株式の取得を含めた株主還元を実施するのか？
- Q3 宮城の生産新棟におけるSmart Productionのコンセプトはいつから検討されていたか、また期待される経済効果は？またエッチング以外の装置への展開について教えてください。
- Q4 究極のウェット現像技術は優れたスペックに見えるが、競合が提案する技術と比較し、劣っている点はないか？また、TELの主要顧客との評価状況や、この新技術でPORを獲得できる時期についても教えてください。
- Q5 新洗浄装置ZEXSTA™は3D NANDでのSiN除去の工程で必要とされるとのことだが、さらなる市場での広がりや、シェア拡大に寄与する製品なのか？また、ZEXSTA™の市場リリース時期は？
- Q6 矩形波を使ったエッチングの機能改善についてご紹介いただいた。エッチング装置は、競合メーカーも極低温技術を搭載した新製品を発表しており、注目度の高いエリア。TELはどのようにして差別化を図っているのか、教えてください。
- Q7 TELは良いエッチング技術を持っていて、長年期待を寄せているが、競合メーカーとのシェアの差がなかなか埋まらないと感じる。TELは開発評価機を顧客サイトにもってくるのが遅いというような話も聞く。一方、最近の極低温エッチング装置の事例のように、開発の速度が従来より早くなってきているようにも思う。この10年で開発の速度をあげる工夫・取り組みをされてきたのであれば、ご紹介いただきたい。
- Q8 プラズマCVDに関して新製品をご紹介いただいたが、PORが取れば業績寄与が大きいと思われる。可能性について教えてください。競合と差別化を図っている点についても教えてください。
- Q9 ALDが主要な成膜装置のなかではシェアが低いですが、どのような課題を認識されているか？また、今回ご紹介された新製品は枚葉式が多かったが、今後、バッチALDのエリアでも新製品の期待をもてるか、考えを教えてください。



- Q10 売上規模を考慮すると TEL のボンディング装置のシェアはどれくらいと見ているか？また、現在の製品群は前工程と先端パッケージングのどちらが強いのか？
- Q11 後工程装置の粗利率は前工程の従来からの装置と同じ水準か？
- Q12 ボンディングにおける御社の強みについて。反りウェーハや歪みへの対応などの説明があったが、どの点が顧客からの評価が高いのか？また、シェアが拡大する強みは？
- Q13 CY2023 末に Ulucus™ L、CY2024 末にリリースした Ulucus™ LX の量産採用時期は？また、どのアプリケーションを想定しているか？
- Q14 CY2025 の WFE 市場における、中国の比率を教えてください。また、アメリカの半導体製造装置メーカーは、中国への輸出制限が今年の収益に影響を与えていると話しているが、TEL は中国への出荷に関して問題がないか？



■ Q&A

Q1 中期経営計画の最終年度(FY2027)が迫ってきている。3兆円という売上高の目標に対して、主要製品ごとにどのように増収に貢献していくかイメージを教えてください。また、営業利益率について、FY2025 Q3の実績が30.5%であったが、中期経営計画の目標である35%に向けて、売上高拡大以外の要素でどの程度利益率を向上していけるとみているか、中期経営計画とIR Dayの説明内容を踏まえて説明してほしい。

A1 中期経営計画が進捗していなかで、FY2025の売上高は2兆4,000億円程度を想定している。FY2027と時期的に重なるCY2026に向けてはWFE^{*1}の2桁成長という想定もお話している。そのような環境で、現在のPOR^{*2}の獲得状況や新製品のリリースが順調に進んでいることに鑑みると、売上高3兆円というトップラインの中期経営計画の目標達成はできると考えている。売上高の拡大と、製品の付加価値・サービスの付加価値の向上に基づいた売上総利益率の改善のデュアルエンジンによって、35%という営業利益率の目標についても達成したい。製品の増収への寄与度については、エッチングが間違いなく大きな寄与度になると思う。マクロ経済の動向等リスクに留意しつつも、成長投資を緩めるつもりはない。中期経営計画はチャレンジングな目標だが、それだからこそ達成する意義があり、全体の進捗としては順調であると考えている。

[▲Top](#)

Q2 中期経営計画の目標に関連して、FY2027に売上高3兆円、営業利益率35%という中期経営計画の目標を達成できれば、営業利益が1兆円を超える。自己資本が大きくなり、ROE30%という目標に達しなくなると思う。ここ数年、積極的な株主還元をしているが、ROEの達成を念頭におくと、引き続き、自己株式の取得を含めた株主還元を実施するのか？

A2 FY2025においては2度の自己株式の取得を実施した。自己株式の取得については様々な要因を考慮しながら機動的に実施し、株主還元を適切に行い、ROE30%以上を達成したいと考えている。

[▲Top](#)

Q3 宮城の生産新棟におけるSmart Productionのコンセプトはいつから検討されていたか、また期待される経済効果は？またエッチング以外の装置への展開について教えてください。

A3 宮城工場に自動倉庫を導入した際に工数が削減でき、効率化において一定の成果を上げた。Smart Production構想は自動倉庫の導入期に検討を開始した。製造、組み立て、検査工程に機械を導入することで、自動倉庫と同様に、人員を増やさずに生産性を高めていく。経済効果として、今後高い成長が期待できるエッチング市場において、2030年以降、毎年100億円以上のコストダウン見込む。売上が大きくなるほどさらに効果は大きくなるだろう。

エッチング以外の展開については、ドライプロセスである成膜はエッチングとの類似点が多く、同様のコンセプト展開ができる可能性は高い。装置の標準化と機能の集約とともに将来展開を考えている。一方、コータ/デベロッパや洗浄のウェット装置群はドライ装置群とは製造方法が異なり、モジュール単位で協力会社にて生産・出荷し、顧客工場を組み立てており、最適化できている。現在のところSmart Production構想をそのまま展開しない。なお、DXは、工場・装置によらず、共通で推進していく。

[▲Top](#)



Q4 究極のウェット現像技術は優れたスペックに見えるが、競合が提案する技術と比較し、劣っている点はないか？また、TELの主要顧客との評価状況や、この新技術でPORを獲得できる時期についても教えてほしい。

A4 究極のウェット現像は、競合の技術を性能で凌駕できる見込み。また、究極のウェット現像は従来の技術の延長であるため、既存の塗布現像装置と親和性が高く、顧客から高い信頼と期待を得ている。量産に向けた評価も進行中。適用世代については、DRAM 1b^{*3}の一部の顧客では既に量産採用済み。DRAM 1c^{*3}以降においても量産に向けた評価が進行中であり、MOR^{*4}工程にも対応予定。ロジック向けにおいては、10A以降で展開予定。

[▲Top](#)

Q5 新洗浄装置 ZEXSTA™ は3D NANDでのSiN除去の工程で必要とされるとのことだが、さらなる市場での広がりや、シェア拡大に寄与する製品なのか？また、ZEXSTA™の市場リリース時期は？

A5 ZEXSTA™ は3D NANDのSiNの除去に加え、3D DRAMへの構造変化に伴い、さらに貢献できると考えている。ZEXSTA™は今後洗浄の工程増加に伴い、一般的な洗浄から微細なウェットエッチング工程まで幅広く、大きくシェアを拡大できると考えている。ZEXSTA™のリリース時期は顧客と評価推進してきており、早ければ1~2年以内に採用されようと考えている。本日はご紹介した高生産性のバッチやSPM^{*5} Vaporなど、市場に先んじて導入している。洗浄市場でNo.1を取りたいと考えている。

[▲Top](#)

Q6 矩形波を使ったエッチングの機能改善についてご紹介いただいた。エッチング装置は、競合メーカーも極低温技術を搭載した新製品を発表しており、注目度の高いエリア。TELはどのようにして差別化を図っているのか、教えてほしい。

A6 より効率的なガスの供給・副生成物の排気・垂直にエネルギーを伝えることの組み合わせにおいて、それぞれのパラメータをどう調整するかというところに、技術の肝がある。パラメータの組み合わせは無数にあり、競合メーカーもガスケミストリーを使って、顧客のニーズに合わせた形状改善を進めているのだと考えている。TELは矩形波やパルスのパラメータもうまく組み合わせ、顧客のデバイスにあわせて提供し差別化を図っている。

[▲Top](#)

Q7 TELは良いエッチング技術を持っていて、長年期待を寄せているが、競合メーカーとのシェアの差がなかなか埋まらないうと感じる。TELは開発評価機を顧客サイトにもってこるのが遅いというような話も聞く。一方、最近の極低温エッチング装置の事例のように、開発の速度が従来より早くなってきているようにも思う。この10年で開発の速度をあげる工夫・取り組みをされてきたのであれば、ご紹介いただきたい。

A7 顧客の要求をしっかりと把握し、技術の変化点でタイムリーに答えを出すことが最も重要と考えているが、過去、うまく機会を捕えられていなかったこともあった。本日はご紹介した技術は、ここ10年ほど技術開発に投資を継続した成果である。将来の技術を見越した早期からの顧客とのエンゲージメントの重要性が増してきており、ご指摘いただいた開発評価機を顧客に導入するタイミングを逸するといった課題への大きなカウンターアクションになっている。現在は絶縁膜エッチングだけでなく、コンダクタエッチングにおいても、技術競争力がある状態に到達したと自負している。今後は競合を超えて、PORを獲得していきたい。

[▲Top](#)



- Q8 プラズマ CVD に関して新製品をご紹介いただいたが、POR が取れれば業績寄与が大きいと思われる。可能性について教えてほしい。競合と差別化を図っている点についても教えてほしい。
- A8 プラズマ CVD・PVD の市場は非常に大きく、SAM⁶を拡大していきたい。低温で成膜できることからプラズマ CVD が求められており、TEL が提案できるアプリケーションが多く広がってきている。コンタクト・スペーサーといった FEOL⁷のアプリケーションに加え、次世代の配線工程に向けたメタルの埋め込みやエアギャップと呼ばれる寄生容量を下げる革新的な技術もご紹介したプラットフォームに搭載するチャンバーで実現できると考えている。事業として売上に貢献するのは少し先になるが、中期的な目線でしっかりと種をまいておきたい。
- [▲Top](#)
- Q9 ALD が主要な成膜装置のなかではシェアが低いが、どのような課題を認識されているか？また、今回ご紹介された新製品は枚葉式が多かったが、今後、バッチ ALD のエリアでも新製品の期待をもてるか、考えを教えてください。
- A9 TEL の ALD 装置のラインアップとしては、バッチの ALD 装置と、セミバッチの空間分割式の ALD 装置をもっている。デバイスの微細化に伴い、従来 CVD による処理だったものが、ALD に置き換わるということがあがる。その場合、バッチによる生産性のメリットや高温処理による膜質の良さを活用していくプロセスが増えると考えている。アプリケーションをしっかり選別し、それに対して最適な製品を提供することで、ALD セグメントにおけるポジションアップを図っていきたい。
- [▲Top](#)
- Q10 売上規模を考慮すると TEL のボンディング装置のシェアはどれくらいと見ているか？また、現在の製品群は前工程と先端パッケージングのどちらが強いのか？
- A10 社内試算では、ボンディング工程向け装置の TAM⁸に対し 20%以上のシェアを有していると見ている。なお、現時点では前工程に注力している。フュージョンボンディング技術が確立した当時、当社で最も効果的に成長できるセグメントが前工程であった。後工程はこの先 5~10 年にて、ダイレベルなど、先端パッケージングにおいても適用範囲が広がると考えており、技術の転換に合わせ事業成長をしていく。
- [▲Top](#)
- Q11 後工程装置の粗利率は前工程の従来からの装置と同じ水準か？
- A11 半導体の進化において、前工程のみならず先端パッケージングが今後牽引する。先端パッケージングは半導体の性能進化を後押しする技術である。これらに使われる装置は、顧客のデバイス性能向上効果が高く、付加価値の高い製品群である。利益率も前工程の装置と同様の水準である。
- [▲Top](#)



- Q12 ボンディングにおける御社の強みについて。反りウェーハや歪みへの対応などの説明があったが、どの点が顧客からの評価が高いのか？また、シェアが拡大する強みは？
- A12 当社の強みは前工程で培ってきたプラズマ技術、洗浄技術、クリーン化技術を組み合わせた付加価値の高いボンディング装置を提供できること。CMOS イメージセンサーや HBM^{*9} では既に多くの装置を納入しており、量産実績もある。現在、新しいアプリケーションとして、3D NAND やロジックの BSPDN^{*10} およびアドバンスパッケージで引き合いもいただいている。

[▲Top](#)

- Q13 CY2023 末に Ulucus™ L、CY2024 末にリリースした Ulucus™ LX の量産採用時期は？また、どのアプリケーションを想定しているか？
- A13 初めに顧客よりボンダーの POR を獲得し、並行してレーザー製品を展開している。レーザー製品はトリム装置の Ulucus™ L、ならびに剥離装置の Ulucus™ LX があり、顧客がデバイス構造や目的に応じて選択する。よって顧客のボンディング量産導入のロードマップと合わせ、当社の評価と量産に向けた活動を行っている。アプリケーションは先端ロジック/ファウンドリ、3D NAND、DRAM において顧客エンゲージメントが進んでいる。

[▲Top](#)

- Q14 CY2025 の WFE 市場における、中国の比率を教えてください。また、アメリカの半導体製造装置メーカーは、中国への輸出制限が今年の収益に影響を与えていると話しているが、TEL は中国への出荷に関して問題がないか？
- A14 CY2025 の中国比率は 35%程度になるとみている。中国以外の最先端エリアの投資が増えること、また、中国における新興メーカーにおいて、量産の安定化を図るため、新規投資が控えられることで、中国比率が下がっていくと想定している。中長期では 30-35%で推移すると考えている。
中国への輸出規制に関しては、影響は否めないが、状況を注視し、適切な対応を図っていきたくと考えている。

[▲Top](#)

*1 WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

*2 POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*3 1b/1c : DRAM デバイスの世代

*4 MOR (Metal Oxide Resist)

*5 SPM (Sulfuric Acid and Hydrogen Peroxide Mixture) : 硫酸と過酸化水素水の混合液

*6 SAM (Served Available Market)

*7 FEOL (Front End Of Line) : トランジスタ工程

*8 TAM (Total Available Market)

*9 HBM (High Bandwidth Memory) : 高帯域幅メモリ

*10 BSPDN (Backside Power Delivery Network) : トランジスタにパワーを供給する配線が裏面にある構造



FY2025 は 2024 年 4 月～2025 年 3 月の会計年度を指しています。
FY2026 は 2025 年 4 月～2026 年 3 月の会計年度を指しています。
FY2027 は 2026 年 4 月～2027 年 3 月の会計年度を指しています。

本内容は質疑応答のサマリーです。スライドに同期した音声配信は[こちら](#)から。